

JPCA 2023
Show

第52回国際電子回路産業展

JIEP マイクロエレクトロニクスショー

第37回 最先端実装技術・パッケージング展

JISSO PROTEC 2023

第24回 実装プロセステクノロジー展

SDGs デバイス展
SDGsデバイス展

～装置と装置をつなぐ～
WIRE Japan Show
電気・光伝送技術展

Electronics Component & Unit Show
JEP 全国電子部品流通連合会
東京都電機卸商業協同組合

E-Textile/Wearable
イーテキスタイル/ウェアラブル展

Smart Sensing
スマートセンシング

無人化ソリューション展
無人化ソリューション展

Edge Computing
エッジコンピューティング

INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION
InterOpto
インターオプト

Imaging Japan
イメージングジャパン



出展の
ご案内

ここから始まる! ~ Exhibition X ~

2023.5.31_{Wed.} → 6.2_{Fri.} 東京ビッグサイト 東展示棟

電子機器2023
トータルソリューション展

申込開始: 2022年10月17日(月) 10:00~



展示会公式サイトへ

主催: 一般社団法人日本電子回路工業会、一般社団法人エレクトロニクス実装学会、
一般社団法人日本ロボット工業会

共催: 電子デバイス産業新聞【(株)産業タイムズ社】、電線新聞【(株)工業通信】、
(株)JTBコミュニケーションデザイン、
全国電子部品流通連合会/東京都電機卸商業協同組合、株式会社織研新聞社、
一般財団法人光産業技術振興協会

後援(予定): 経済産業省

海外協力: 世界電子回路業界団体協議会(WECC)加盟団体

中国電子回路行业协会(CPCA)、欧州電子回路協会(EIPC)、印度電子工業会(ELCINA)、
香港線路板協会(HKPCA)、米国電子回路協会(IPC)、印度電子回路工業会(IPCA)、
韓国電子回路産業協会(KPCA)、タイ電子回路工業会(THPCA)、
台湾電路板協会(TPCA)

AEIS (Association of Electronic Industries in Singapore)
KPIA (Korea Packaging Integration Association)

2022/10/17版

5G/5G+などの通信、インフラ（ネットワーク、再生可能エネルギー、データセンターなど）、次世代自動車、ロボット、ウェアラブル、センサー、医療・ヘルスケアなどを具現化する技術の総合展示会

エレクトロニクス展示会の中でも専門性・注目度が高く、広く国内外からも多くの来場者を迎え、活発な商談の場としてご活用いただいています。

開催概要

目的	あらゆる電子・情報通信・制御機器に使用される電子回路・実装技術や、用途の広がりを見せるセンサー・E-Textile（ウェアラブル技術）等の新しいコンテンツとソリューション等の展示を加え、技術情報の提供・提案をはかり、併せて電子回路業界及び関連業界全体の発展に寄与する。
会期	2023年5月31日（水）～6月2日（金） 午前10時～午後5時
会場	東京ビッグサイト 東展示棟
運営事務局	株式会社JTBコミュニケーションデザイン
本部事務局	一般社団法人 日本電子回路工業会（JPCA）
入場料	1,000円（税込） ※WEB登録で無料

2022年開催実績

会場	東京ビッグサイト 東4～6ホール+会議棟
出展規模	313社 / 845小間
来場者数	27,972名

構成展示会・出展対象

電子回路技術  第52回国際電子回路産業展 ●プリント配線板技術展 製品（電子回路基板等の電子機器）、設計技術、信頼性/検査技術、主材料/絶縁材料、機能材料/プロセス材料/資機材、製造装置/設備、環境システム、物流システム ●半導体パッケージング・部品内蔵技術展 モジュール基板/モジュール基板実装/部品内蔵に関する技術全般（製品/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等） ●フレキシブルプリント配線板製品出展エリア フレキシブルプリント配線板に関する技術全般（製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等） ●機器・半導体受託生産システム展 EMS等の電子電気機器及び半導体に関する受託サービス全般（製造/関連製品/設計/信頼性検査/材料・機能材料/関連装置/関連システム等） 主催：一般社団法人日本電子回路工業会	高密度実装技術  マイクロエレクトロニクスショー 第37回 最先端実装技術・パッケージング展 実装・電子技術に関する技術全般（材料/回路・実装設計/高速高周波/電磁特性/電子部品・実装/光回路実装/環境調和型実装/半導体パッケージ/マイクロメカトロニクス実装技術/各種関連製造装置等） 主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会	電子部品実装技術  第24回 実装プロセステクノロジー展 ■電子部品実装機および関連機器・システム：電子部品装着機（マウンタ）、電子部品挿入機（インサータ）、クリームはんだ印刷機、はんだ付け装置（リフローオープン）、ティスベンサ ■実装関連機器・システム：搬送システム、AGV、自動倉庫、テーピングマシン、材料、バルクフィーダ、その他フィーダ、自動組立装置、レーザーマーキング装置、洗浄装置、洗浄剤 ■半導体実装機・システム：ボンディング装置、フリップチップ実装システム、COBシステム ■産業用ロボット：ハンドリングロボット、組立ロボット、搬送ロボット、AMR ■検査・試験装置：基板外観検査装置 半導体製造関連検査・測定装置 ■実装設計システム：設計ツール生産最適化ソフトウェア、実装プログラミング装置 ■実装デバイス・部品および関連材料 ■実装デバイス包装材料 ■実装接合システム・はんだ/接合材料 ■高周波対応装置・部品・材料 ■環境関連装置・材料 主催：一般社団法人日本ロボット工業会		
SDGs 具現化技術  SDGsデバイス展 ・再生可能エネルギー関連エレクトロニクス ・パワーエレクトロニクス関連 実装/材料 ・パワー半導体/パワーデバイス（IGBT、MOSFET、パイオラトランジスタ等）、各種メモリ（S-RAM、D-RAM等）、半導体パッケージ、部品内蔵モジュール、メタルコアプリント配線板、熱ソリューション、太陽電池、バッテリー、水素燃料、パワエ、関連各種デバイス、他 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 電子デバイス産業新聞（株）産業タイムズ社	電気・光伝送技術  ～装置と装置をつなぐ～ WIRE Japan Show 電気・光伝送技術展 ワイヤー・ケーブル等を用いる伝送技術全般（産業用機器/電線・ケーブル及びコネクタ/電線加工機/配線用部材/ワイヤーハーネス/電線・ケーブル用計測器/各種装置/検査技術/装置間（M2M）伝送/光伝送等） 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 電線新聞（株）工業通信	半導体・電子部品  Electronics Component & Unit Show JEP 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合 半導体・電子部品等を用いたソリューション技術全般（半導体/電子デバイス/センサー/機構部品/FA制御機器/計測器/電源/IoT・M2Mソリューション/もの作りソリューション・システム等） 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 全国電子部品流通連合会 東京都電機卸商業協同組合	高性能テキスタイル  E-Textile/Wearable イーテキスタイル/ウェアラブル展 電子技術と繊維・衣料が融合するイーテキスタイル（スマートテキスタイル/ストレッチャブル技術/ウェアラブル技術）に関する技術全般（繊維素材・材料/導電性素材・材料/編・織技術/プリント・マーキング技術/フィルム/センサー/信頼性検査/関連装置・システム等） 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社織研新聞社	
センサー技術  Smart Sensing スマートセンシング センサー及びセンシングシステムに関する技術全般（センサー/センサーノード関連、半導体/部品デバイス、電子機器、通信デバイス/ネットワークシステム、ソフトウェア関連、データプラットフォーム、電源、その他周辺機器/技術/サービス） 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン	無人化技術・ソリューション  無人化ソリューション展 無人化技術・ソリューション、または無人化のための省力化・遠隔化・自動化・非接触化の技術・ソリューション全般 監視システム/遠隔操作システム/先進運転支援システム/ディープラーニング/非接触タッチレス/無人営業サービス/AR/異常検知/顔認証/AI等 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン	エッジソリューション技術  Edge Computing エッジコンピューティング 低遅延、高安全、低通信量などの優位性をもつエッジソリューション全般 ボードコンピュータ・シングルボードコンピュータ/エッジデバイス/OS/エッジAI/アプリケーション/画像分析/エッジセキュリティ/各種システム等 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン	光&次世代アプリケーション・ネットワークシステム  INTERNATIONAL OPTOELECTRONICS EXHIBITION InterOpto インターオプト レーザー・光源（半導体、ファイバ、超短パルス）/光素子・部品（レンズ/フィルタ、ガラス、光スキャナ）/測定装置・光分析機器/生産向けレーザーシステム（レーザー加工装置、マーキング装置）/光情報通信（可視光通信、5G） 主催：一般財団法人光産業技術振興協会 企画・推進：株式会社JTBコミュニケーションデザイン	画像処理・センシング技術  Imaging Japan イメージングジャパン 各種カメラ・センサ機器/画像処理機器/画像認識・画像理解技術/計測・測定技術/LIDAR 共催：一般社団法人日本電子回路工業会 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

2022年出展者の目的・成果・コメント

出展者のコメント (出展者アンケートより ※コメントの一部を抜粋)

(出展の) 成果は、他の展示会より上。来場者と深くディスカッションできました。



弊社のターゲットとなるお客様が多数来場し、大変充実した展示会となりました。



コロナ禍が収まらない中、3年ぶりの出展で正直不安もありましたが、予想以上の賑わいに、やはりリアルに勝るものはないとつくづく感じました。思い切って出展して良かったです。

ブースへの来場者数は期待以上で参加して良かったです。オンライン(での出展製品掲載)でもリードが取得できる試みはありがたいです。



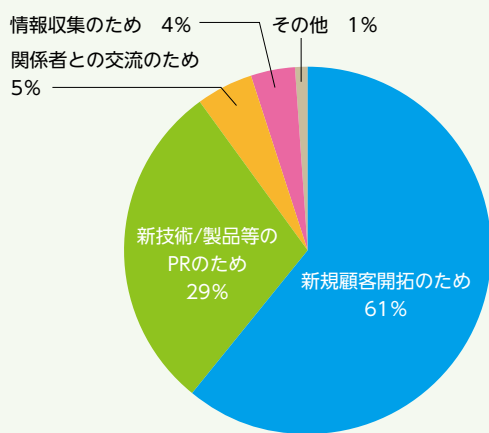
冷やかしの人が少なく、テーマを持って来場されている顧客が多く感じました。



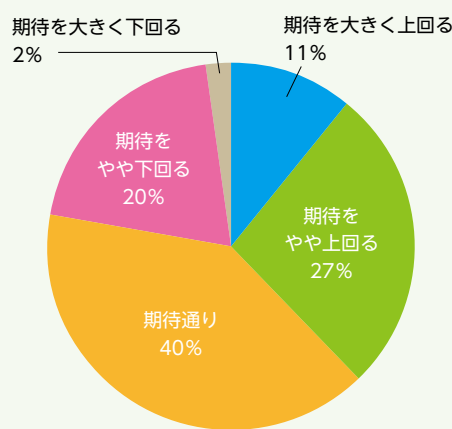
地方の中小企業が新規の顧客と繋がりを持つには、やはり首都圏で開催されるリアル展示会が非常に重要ですので、今後も開催をお願いします。



出展の目的



出展の成果



NEW 「出展者交流会」の開催

会期中に出展者間のビジネス・ネットワーキングを促進するための「出展者交流会」を開催します！

各分野における想定される来場企業

- 自動車関連** アルプスアルパイン、東海理化、スタンレー電気、デンソー、三菱電機、日産自動車、トヨタ自動車、パナソニックインダストリー、パナソニック オートモーティブシステムズ、日本特殊陶業、日本発条、NOK、パイオニア、ミライズテクノロジーズ、アイシン、マレリ、丹羽鉄工所、東洋電装、アサヒ電子、豊田自動織機、アルパインマニュファクチャリング、太陽工業、日東工業、NNP電子、豊田合成、JVCケンウッド、ヨコオ、日立Astemo、ヤマハ発動機
- OA産業関連** パナソニック コネクト、オムロン、三菱電機、リコー、パナソニック インダストリー、山洋電気、キヤノン、オリエンタルモーター、東芝テリー、PFU、JUKI、FUJI、コニカミノルタ、横河マニュファクチャリング、安川電機、理化学工業、渡辺電機工業、能美防災、アズビル、キーエンス、タムラ製作所、渡辺電機製造、理想科学工業、菊水電子工業、コーセル、マグネスケール、戸上電機製作所、日立産機システム、富士電機、ヤマハ発動機
- 情報・通信関連** パナソニック コネクト、キヤノン、華為技術日本、村田製作所、大日本印刷、日本電気、京セラ、コニカミノルタ、凸版印刷、パナソニック、古野電気、パナソニック インダストリー、沖電気工業、東芝、ニコン、ヴェイ・エス・テクノロジー、富士電機、エンプラス、サン電子、スタンレー電気、テクノホライゾン、日立国際電気、住友電気工業、太陽誘電、エドモンド・オブティクス・ジャパン、ミツミ電機、共和電業、東プレ
- AV・家電関連** パナソニック、ソニーグループ、パナソニックインダストリー、山洋電気、キヤノン、パナソニック コネクト、リコー、カシオ計算機、ダイキン工業、マクセル、ソニーグループ、オーディオテクニカ、ジャノメ、パナソニック ホールディングス、LG Japan Lab、TOTO、タニタ、JVCケンウッド、シグマ、三菱電機、TOA、シャープ、パナソニック エンターテインメントアンドコミュニケーション、長府製作所、SMK、オーディオテクニカフクイ、サムスン日本研究所、パナソニック オペレーションズ
- 医療機器関連** オリジナル、リオン、日本電子、ニコン、堀場製作所、キヤノン・コンポーネンツ、トプコン、オートシステム、ツガワ、メテック、群馬コイケ、テルモ、浜松ホトニクス、イー・アンド・ディ、ダイトウ、ナカニシ、フォースエンジニアリング、フクダ電子、興和、大永工業、東亜電気工業、平山製作所、クリエートメディック、パラマウントベッド、ユニバーサル・バイオ・リサーチ、朝日インテック
- 航空宇宙関連** 東京計器、トプコン、三菱電機、IHI、パナソニックコネクト、三菱重工業、SMC、三協電精、NECネットワーク・センサ、理工電気、ANAスカイビルサービス、MSR、NTT e-Drone Technology、ソラシドエア、タイコ エレクトロニクス ジャパン、島田理化学工業、東芝電波プロダクツ、日本ムーク、Green Hills Software、NECスペーステクノロジー、アルウェットテクノロジー、ファーストヴィレッジ、国士舘大学、日計電測
- 半導体・電子部品製造** 凸版印刷、京セラ、TDK、大日本印刷、太陽誘電、YITOAマイクロテクノロジー、ソニーセミコンダクタソリューションズ、SEMITEC、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、パナソニック コネクト、サンケン電気、ローム、三菱電機、内藤電誠工業、ケル、日本航空電子工業、パナソニック インダストリー、ヒロセ電機、タムラ製作所、コネクテックジャパン、富士電機、アナログ・デバイス、京都セミコンダクター、FUJI、I-PEX、SMK、キオクシア、日清紡マイクロデバイス、ヤマハ発動機、ヤマハロボティクスホールディングス
- 光技術** ウシオ電機、パナソニック、ニコン、スタンレー電気、日亜化学工業、大日本印刷、HOYA、ヴェイ・エス・テクノロジー、アンリツ、エドモンド・オブティクス・ジャパン、エンプラス、オプトクエスト、ギガフォトン、レボックス、京セラ、古河電気工業、NTTエレクトロニクス、シーシーエス、シチズン電子、スペクトラ・フィジックス、ソニーグループ、三菱電機、朝日ラバー、浜井電球工業
- 電子回路基板** パナソニック コネクト、シークス、バスコン、スミトロニクス、図研、ASTI、FUJI、アドバンテック、ブラックス、東京ドローイング、日本サーキット、アサヒ電子、エム・ディー・システムズ、沖電気工業、京セラ、光商工、三菱電機エンジニアリング、東亜エレクトロニクス、キヤノン、ソニーグループマニュファクチャリング&オペレーションズ、三菱電機
- その他** 郵船ロジスティクス、ヤマト運輸、ヤマトボックスチャーター、JR東日本商事、ANAスカイビルサービス、東日本旅客鉄道、西日本鉄道、JR東日本テクノロジー、JR東日本コンサルタンツ、東日本高速道路、NEXCO西日本イノベーションズ、全日空商事、JR東日本スタートアップ

■ 出展料金

区分		1小間/9m ²
一般		451,000円(税込)
会員企業*1	通常	385,000円(税込)
	早期	360,800円(税込)
	20小間以上	338,250円(税込)
	増小間割引*2	増加分50%OFF

*1 対象：JPCA会員/JIEP正会員・賛助会員/JARA正会員・賛助法人会員・準会員/JEP・TEP正会員

*2 増小間割引：2018年以降にご出展いただいた最大小間数からの増小間分の出展料金は50%OFFとさせていただきます。

※1小間のサイズは、3m×3m=9m²です。

※小間設営・装飾費、電気・給排水、小間内清掃費、廃棄物処理費などの工事費および使用料は含まれていません。

■ 出展申込 (2022年10月17日(月) 10:00～より開始)

展示会ウェブサイトよりオンラインでお申込みください。(www.jpccashow.com)

申込開始は2022年10月17日(月) 10:00～より開始します。

出展申込書を使用する場合は、メールもしくはFAXでお申込ください。

貴社の出展製品・技術・サービスに応じて、ご出展構成展をお選び頂き、必ず、出展申込書裏面の「出展規約」をご確認ください。

専用の出展申込書が用意されている展示会については、当該の出展規約が適用されます。

出展申込書を受理後、請求書を発行しますので、記載の期日までにお振込みをお願いします(原則会期前振込)。請求書は出展者専用webよりダウンロードをお願いします。

■ 申込締切

早期申込締切日(対象：会員企業)	2023年1月31日(火)
最終申込締切	2023年2月28日(火)

※早期料金・対象については出展料の欄をご確認ください。

※予定の小間数に達した場合、締切らせて頂きます事を予めご了承ください。

■ 取消料

出展申込者の都合により出展を取り消す場合(全てまたは一部)下記の通り取消料を申し受けます。

書面による取消通知を受理した日	取消料
～2月28日(火)	小間料金の 30%
3月1日(水)～3月31日(金)	小間料金の 50%
4月1日(土)～4月30日(日)	小間料金の 70%
5月1日(月)～	小間料金の100%

■ 開催までのスケジュール

2022年10月	2023年1月	2月	3月	4月	5月	6月
▲ 10月17日(月) 10:00～ 出展申込受付開始	▲ 1月31日(火) 出展早期申込締切 (対象：会員企業)	▲ 2月28日(火) 出展最終申込締切	▲ 3月上旬 出展者説明会開催 出展マニュアルの公開 ▲ 3月中旬 小間位置選択会開催	▲ 4月上旬 招待状発送 来場登録開始	▲ 5月29日(月)～ 30日(火) 搬入期間 ▲ 5月31日(水)～6月2日(金) 展示会開催	※最終日即日撤去
← 3月中旬～随時 各種提出書類期限						

●主催者による安全対策・対応方針について

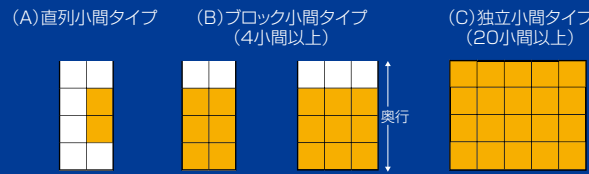
当展では参加者および主催、関係者の新型コロナウイルス感染拡大低減の対策を行い、展示会の安全性に配慮し、開催いたします。

今後は、政府や関係省庁、自治体の方針や要請を考慮し、施設との協議、連携のうえ計画を推進いたします。

●万が一の開催中止対応

新型コロナ(COVID-19)を要因として展示会の中止が決定した場合、出展料は100%返金します。※詳細は出展規約をご確認ください。

■ 小間形態



※小間タイプのご希望に添い加える場合もありますので、予めご了承ください。

■ 小間位置の決定

小間位置選択会(2023年3月中旬開催予定)にて小間位置を決定いたします。

原則、同一展示会における同一申込小間数、小間形態、機能別展示会技術テーマ等を考慮した展示会レイアウトに基づき、出展申込順で選択順位を決定します。

詳細は10月17日(月) 10:00～公開する出展申込規約をご確認ください。

■ 出展者サポートプログラム (有料・オプション)

バーコードリーダーサービス、各種広告プラン等 出展の効果を高めるプログラムをご用意します。

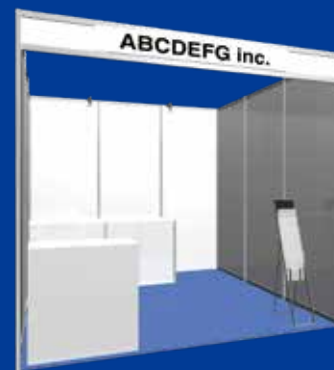
※詳細は別途出展者説明会でご案内いたします。

■ パッケージブースプランのご案内

●1小間ベーシックプラン

価格：¥82,500(税込)

最低限必要なブース造作、電源、カーペットなどが付属したプランです。



本部事務局

一般社団法人 日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階

TEL：03-5310-2020 FAX：03-5310-2021 E-mail：show@jpcca.org

運営事務局

株式会社 JTBコミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

TEL：03-5657-0767 FAX：03-5657-0645 E-mail：jpcashow@jtbcom.co.jp



展示会公式サイトへ